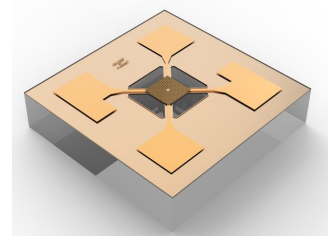


## HHC1000 微热板芯片

### 概述

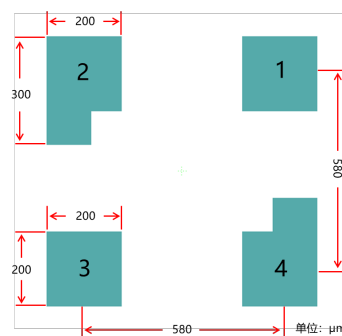
HHC1000 微热板芯片基于MEMS制造技术，用于MEMS气体传感器。采用悬膜式结构，功耗低，可靠性高。集成微型加热器和叉指电极，微型加热器用于为气体传感器提供合适的工作温度，叉指电极用于检测气敏材料的电阻变化。



### 特征

- 低功耗： < 30 mW
- 长寿命： > 10 years
- 小尺寸： 1.0 mm × 1.0 mm × 0.5 mm

### 引脚图

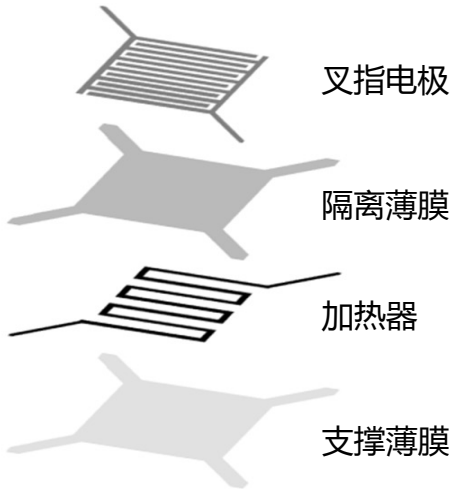


### 引脚标识

PIN	描述
1	测量电极1
2	加热电极1
3	测量电极2
4	加热电极2

### 性能参数

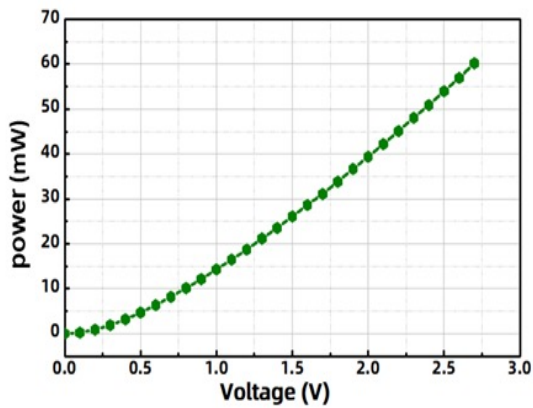
项目	典型值
常温电阻	45±5 Ω
加热元件材料	Pt
测量元件材料	Pt
典型加热电压	1.5 V
寿命	> 10 years (@1.5 V)



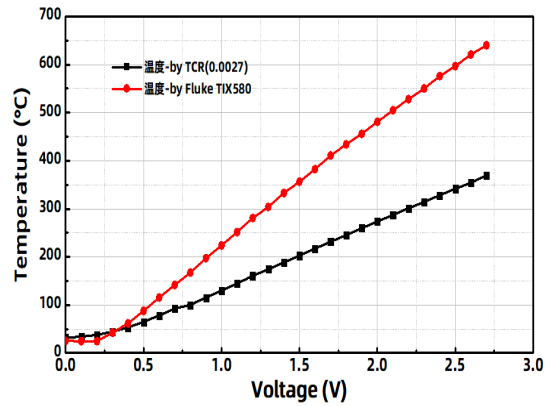
- 1、支撑薄膜为敏感区域提供结构支撑，保障器件的强度。
- 2、加热器由铂制成，既可以作为加热元件为传感器提供工作温度，也可以作为温度传感器。
- 3、隔离薄膜用于阻隔加热器和叉指电极之间的电连接。
- 4、叉指电极用于测量传感器气敏材料的电阻变化。

## 关系图

### 功耗与电压关系图



### 温度与电压关系图



## 注意事项

- 1、芯片贴装时，注意静电防护。
- 2、请勿触碰MEMS芯片表面中心区域，会造成不可逆转的损坏。
- 3、温度与电压的关系分别通过TCR计算和红外热像仪测量，数值仅供参考。



T. 0551-65332010

A. 合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期D6栋

W. <http://www.hmnst.com>

MEMS 传感技术供应商